

当前位置: 科技频道首页 >> 军民两用 >> 光机电 >> 高温压力传感器芯片的制作方法

请输入查询关键词

科技频道

搜索

高温压力传感器芯片的制作方法

关键词: **芯片** **压力传感器** **生产工艺**

所属年份: 2001

成果类型: 应用技术

所处阶段:

成果体现形式:

知识产权形式:

项目合作方式:

成果完成单位: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所

成果摘要:

这种高温压力传感器芯片的制作方法, 最为关键的工艺是将有单晶碳化硅外延层的硅片与外层被氧化的硅片用浓硫酸清洗, 再用去离子水冲洗, 然后将其中硅片的碳化硅面与另一硅片的氧化硅面进行键合, 最后将其放入氢氧化钾溶液中腐蚀, 去除碳化硅外延层的衬底硅层。这种方法不仅简化了高温压力传感器芯片的制作工艺, 而且保证了这样制造出来的芯片的单晶碳化硅高温半导体特性的充分发挥。

成果完成人:

[完整信息](#)

行业资讯

- 塔北地区高精度卫星遥感数据处理
- 综合遥感技术在公路深部地质...
- 轻型高稳定度干涉成像光谱仪
- 智能化多用途无人机对地观测技术
- 稳态大视场偏振干涉成像光谱仪
- 2001年土地利用动态遥感监测
- 新疆特克斯河恰甫其海综合利...
- 用气象卫星资料反演蒸散
- 天水陇南滑坡泥石流遥感分析
- 综合机载红外遥感测量系统及...

成果交流

推荐成果

- [容错控制系统综合可信性分析...](#) 04-23
- [基于MEMS的微型高度计和微型...](#) 04-23
- [基于MEMS的载体测控系统及其...](#) 04-23
- [微机械惯性仪表](#) 04-23
- [自适应预估控制在大型分散控...](#) 04-23
- [300MW燃煤机组非线性动态模型...](#) 04-23
- [先进控制策略在大型火电机组...](#) 04-23
- [自动检测系统化技术的研究与应用](#) 04-23
- [机械产品可靠性分析--故障模...](#) 04-23

Google提供的广告

>> 信息发布

版权声明 | 关于我们 | 客户服务 | 联系我们 | 加盟合作 | 友情链接 | 站内导航 | 常见问题

国家科技成果网

京ICP备07013945号